

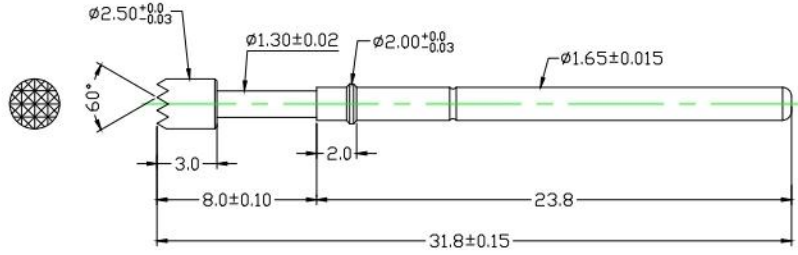
PCB金手指SF-PA1.65 BY 31.8-H2.5

金手指

品名	PCB金手指SF-PA1.65 BY 31.8-H2.5
规格 & 数量	规格 数量 单位
品名	5A
重量	350g±50gf @4.0mm金手指
包装规格	包装规格

SFENG





Materials(Plated) (材質與鍍層):  
Barrel(針套) : Brass(黃銅) , Au on Ni Plated  
Plunger(針軸) : BeCu(鈹銅) , Au on Ni Plated  
Spring(彈弓) : SWP (琴鋼線) , Au on Ni Plated

Specifications (技術要求):  
Current Rating(額定電流) : 5A  
Contact Resistance(接觸電阻) : 50mΩ  
Full Stroke(滿沖程) : 5.00mm  
Rated Stroke(額定沖程) : 4.00mm  
Spring Force(額定彈力) : 350±50gf@ load 4.00mm

名称: SF-PA1.65X31.8-H2.5						胜峰科技					
说明:						1. 所有尺寸单位为mm 2. 未注图示尺寸公差:按GB1801-79 11级精度执行					
标记处数			更改文件号			签字			日期		
设计	标准化		图样标记			视图	质量	比例			
校对	审定		S			A	☯	/			
审核	制图		日期			共 1 页 第 1 页					
工艺	日期		2019-8-29								

□□□□□□

1. □□□24□□□□□□□□your inquiry□□□□□□□□□□

2. Customized design □□□□□□ OEM □□□□□□□□□□

3. □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

4. □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□

□□□□□□□ □□□□ [PCB](#) □ [ICT](#) □ [FCT](#)□□□ □;

□□□□□□□□□□ 2□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□ □□□ &□□□□□□□□□□□□□□;

□□□□□□ □□□□ [BGA](#) □□□□□□□□□;

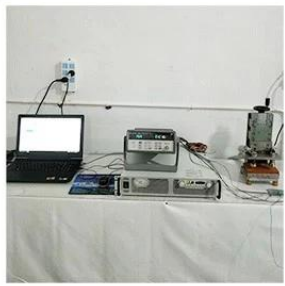
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ QZ□□□ VZ□□□□□ LM□□□□

□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□;

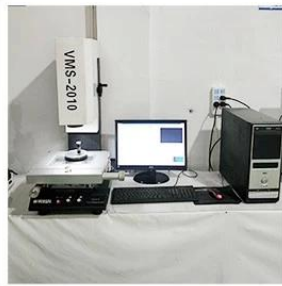
□□&□□□□□□□/□□□□;

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 30□ OK□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ POM□□□□□□□□□□

□□ □□



1. Agilent current testing



2. Quadratic element



3. Load Curve Meter



4. Bond Test



5. Life Fatigue Test



6. Microscope

□□□□

Standard products will be delivered out within 3 days. Customized products will be sent out within 15 days.

